

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2023-028

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司根据项目实施的实际情况做出部分募投项目延期的议案，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年11月1日，中国证监会出具《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638号），批准公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次公开发行的股份数量为1,500万股。2022年12月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16225号），经审验，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1元，发行价格100.66元/股，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币131,222,672.46元，实际募集资金净额为人民币1,378,677,327.54元。公司首次公开发行募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

二、募投项目基本情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资 总额	截至 2022 年 12 月 31 日募集资金 累计投入	截止 2022 年 12 月 31 日投入进 度 (%)
1	10G、25G 光芯片产线建设项目	57,000.00	27,172.37	47.67
2	50G 光芯片产业化建设项目	12,000.00	2,876.91	23.97
3	研发中心建设项目	14,000.00	589.60	4.21
4	补充流动资金	15,000.00	-	-
	合计	98,000.00	30,638.88	-

注：上述募集资金累计投入包含 2023 年 1 月 12 日经董事会审议通过使用募集资金置换预先前期以自有资金投入的金额。

三、本次募集资金投资建设项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募投项目延期情况

结合目前公司“50G 光芯片产业化建设项目”和“研发中心建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将前述项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定 可使用状态日期	现计划项目达到预定可 使用状态日期
1	50G 光芯片产业化建设项目	2022 年 12 月	2024 年 12 月
2	研发中心建设项目	2022 年 12 月	2024 年 12 月

（二）本次部分募投项目延期原因

根据战略发展需求，公司共规划和建设三个募投项目。其中，“10G、25G 光芯片产线建设项目”有助于解决公司目前所面临的 10G、25G 光芯片产线的产能问题，从而提升市场供应能力，满足客户需求，促进公司的长远发展；“50G 光芯片产业化建设项目”有助于 50G 等高速光芯片的批量生产。“研发中心建设项目”主要系公司现有研发中心硬件投入的升级。

在项目建设内容方面，在生产设备购置前，公司需完成主要的厂房、宿舍楼、超净室车间、污水处理系统等基础性设施投入。因前期的厂房和宿舍楼的土建、工程安装的建设进度低于预期，加之公司的设备购置、安装和调试周期较长，从而导致总体募投项目的建设进度有所推迟。

截止目前，公司的基础性设施投入已基本完成，从硬件设施方面可保障后期产能的快速导入。因而，在满足市场预期需求的前提下，为灵活匹配固定资产和产能导入速度，提高资金使用效率，公司在上述三个项目投资建设实施中采用

了分步建设的安排。第一步：公司率先安排“10G、25G 光芯片产线建设项目”的建设投资，并在生产线设计方面进行通用性设计，兼容 50G 等高速率光芯片的生产标准要求；第二步：公司根据市场和经营需求情况，进行“50G 光芯片产业化建设项目”和“研发中心建设项目”的建设。

四、重新论证募投项目

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额 50%，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。”

（一）50G 光芯片产业化建设项目

1、项目实施的必要性

（1）抓住市场机遇、实现科研成果产业化

光模块的小型化、低成本及高速率是产品迭代的主要方向。随着 400G 光模块商用化、800G 光模块进入设计验证测试阶段，数据中心市场光芯片需求迭代进程不断加速，高速率光芯片的应用场景亦不断延拓。根据 Omdia 对数据中心和电信市场激光器芯片的预测，高速率光芯片市场的增长速度将远高于中低速率光芯片。目前，国内 50G 及以上高速率光芯片亟待发展，相关领域的提前布局势在必行。

（2）推动高端光芯片国产化替代进程

目前，国内企业主要集中于 2.5G 光芯片产品的生产和制造，10G 和 25G 中高速率光芯片逐渐实现量产，而 50G 及以上高端光芯片生产仍主要集中在美日企业中，国内需求极度依赖进口。近年来国际形势的变化在一定程度上制约了我国通信产业的建设及通信行业厂商的发展。随着光通信行业的发展，光芯片领域的战略地位将进一步凸显。本项目生产的 50G 光芯片将有助于打破高端光芯片的国际进口依赖，推动实现国产化替代，促进我国通信建设和产业发展。

（3）丰富产品结构，巩固行业领先地位

高速率、大带宽的光通信市场应用的快速迭代，进一步扩大了高速光芯片的市场需求。受贸易摩擦影响，抢占高速光芯片市场已成为国内光芯片企业的竞争焦点，行业内的领先企业积极探索并布局高速光芯片产品，力争突破技术瓶颈，

尽早实现商业化应用。“50G 光芯片产业化建设项目”的落地，将有助于公司拓展下游市场，丰富产品种类，优化产品结构，进一步巩固行业领先地位。

2、项目实施的可行性

（1）国家政策的大力支持，为项目实施提供制度保障

针对芯片行业所面临的“卡脖子”难题，国家出台了一系列支持政策。2020年8月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，在财税、投融资、研究开发、进出口等方面进行规定，致力于优化产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量；“十四五”规划把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，芯片行业发展在其中亦被重点提及；2021年3月，工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，提出要进行产业链强链补链行动，着力提升核心芯片、网络设备、模块、器件等的研发制造水平。在芯片逐步实现自给的过程中，高端芯片的发展具有重要意义，将受益国家政策乘势而起。

（2）核心技术与 IDM 模式，为项目实施提供技术保障

在多年行业深耕中，公司通过创新研发实现了“2.5G-10G-25G”及更高速率光芯片的突破，获得了客户的高度认可，积累了包括两大技术平台、八大核心技术等在内的丰富经验，能够为项目的顺利实施提供充分的技术保障。

此外，公司建立的 IDM 模式能够助力缩短产品研发周期，实现光芯片生产的自主可控，迅速应对动态市场需求，并能够有效控制生产良率、周期交付、产品迭代与风险管控等，为项目实施提供有力支持。

（3）前期配套设施健全，并成功募集资金，可以确保后期项目顺利导入

截至目前，公司已基本完成生产基地的厂房、宿舍楼、超净室车间、污水处理系统等基础性设施投入，且公司已经登陆 A 股资本市场，并成功募集资金，上述基础设施和募集资金足以支持“50G 光芯片产业化建设项目”的后续投入和正常运营。因此，公司可以根据市场需求情况，安排该项目的投入和顺利投产。

（二）研发中心建设项目

1、项目实施的必要性

（1）实现技术升级，延拓产品应用领域

数字应用技术发展对数据传输的带宽、延时性、可靠性不断提出新要求，仅通过增加端口数量的方式已难以满足需求，更高带宽性能光芯片的发展具有必

要性。由于网络带宽的升级，400G/800G 以及光电合封逐步投入生产，硅光技术所具备的高集成度和批量后的低成本特性逐步得到显现，而与之匹配的大功率硅光光源作为一个新的产品类别则得到了光芯片厂家的重视。此外，硅光技术因其高集成度及低成本优势成为未来的突破点，有望拓宽光芯片的应用领域，如车载雷达、消费电子等。公司唯有保持对技术发展的高度敏感，增加技术研发投入，方能持续实现技术升级，开拓新发展领域并推动业绩高速增长。

（2）提高研发效率与研发质量

持续创新是公司产品的核心竞争力，而提高产品设计与测试能力是技术创新的关键点。随着产品品类的开发升级和业务的飞速发展，公司提高研发效率与质量的需求愈发强烈。公司拟购置先进的电子束曝光系统、金属有机气相外延炉、高精度光刻机等生产设备和芯片光电测试系统、高频测试系统等检测设备及设计开发软件，提升研发的软硬件设施水平，建立标准化研发平台，提升核心竞争力。

（3）改善公司研发环境、吸引高素质人才

光芯片行业是典型的高技术行业，对从业人员的素质要求极高。良好的研发环境和技术工艺的积累对于吸引、培养高素质专业人才具有重要意义。公司拟通过本项目购置先进生产检测设备和设计开发软件，改善公司研发环境，吸引、培养高端人才，从而抓住国内光芯片行业发展的契机，积极研发高速率光芯片和面向硅光的光芯片等产品，并着力延拓公司光芯片应用领域，力争赶超国际第一梯队，实现成为国际一流光芯片公司的愿景。

2、项目实施的可行性

（1）丰富的行业经验，为项目实施提供有力支持

公司致力于为国内外客户提供高品质、高性能的激光器芯片，经过多年发展，积累了丰富的行业经验，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。对客户需求的掌握及明确的开发设计方向，助力研发中心更迅速、更准确地把握市场热点，有效利用人力、物力快速开展研发工作，提高公司新产品、新技术的投放速度，保证本项目能够实现预期目标。

（2）科学的人才梯队建设与长效的激励机制，为项目实施提供人才保障

公司在发展过程中始终坚持“以人为本”的管理理念，高度重视管理、技术科研人才的培养和引进，并在创新机制上为各类人才搭建平台，形成人尽其才、

才尽其用的良好氛围。公司通过公开招聘、公平竞争、量化考核等管理办法，不断完善企业内部的人才流动机制和动态管理机制，优化人力资源结构；此外，公司坚持以全员培训为基础、分层培训为重点，通过开展岗前培训、内部培训、选派人员外出培训等方式，着力培养适应公司发展的各类人才。目前公司拥有一支行业经验丰富、创新能力强、学科背景多元的研发团队，研发人员技术方向涵盖半导体物理、机械、微电子等多个领域，强大的研发团队为研发中心建设项目提供了必要的人才保障。

(3) 高效的研发管理体系，为项目实施奠定坚实基础

公司高度重视研发组织管理工作，建立了完善的组织架构，研发部下设晶圆工程、技术研发、NPIE、芯片测试等机构，职责明确，研发工作组织顺畅有效。此外，公司建立并完善了《设计与开发控制程序》《研发质量管控流程》等规范管理制度。公司完善的研发管理体系为研发中心项目的实施奠定了坚实的基础。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次对部分募投项目延期调整是根据项目实际情况而做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目时间计划的改变，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意《关于部分募投项目延期的议

案》。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质上的影响，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

源杰科技本次部分募投项目延期是基于部分募投项目实际情况做出的决定，本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东的情形。

保荐机构对源杰科技本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日